

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 58207634 A

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

(43) Date of publication of application: 03.12.83

(51) Int. CI H01L 21/30

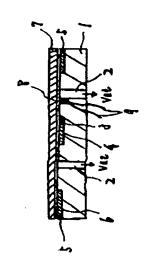
(21) Application number: 57091044 (71) Applicant: SEIKO EPSON CORP
(22) Date of filing: 28.05.82 (72) Inventor: IWAMATSU SEIICHI

(54) POSITIONING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To control temperature of the wafer supporting base of a positioning device with a high accuracy by a method wherein two or more electrodes which enable conduction at least to a semiconductor are formed on the surface of the semiconductor wafer supporting base.

CONSTITUTION: Ventilating holes 2 for vacuum chuck are formed through the supporting base 1 composed of a ceramic, the center electrode 3 of the surface and the lead wire 4, and the end part peripheral electrodes 5 of the surface and the lead wire 6 are formed; then the Si wafer 7 is chucked by vacuum onto the supporting base, and the back surface thereof contacts the electrodes 3 and 5, conduction occurs between the electrodes 3 and 5, and thereby they are heated by the self-resistance of the semiconductor itself, the wafer temperature is set to a temperature detection sensor for control of the wafer temperature and thus contacts the back surface of the wafer 7, and is led to an external electric circuit by lead wires 9, and accordingly the temperature is controlled by the feeding back.



(9) 日本国特許庁 (JP)

砂特許出額公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—207634

60Int. Cl.3 H 01 L 21/30

26-JUN-2007

識別記号

庁内整理番号 6603-5F

EPPING HERMANN FISCHER

砂公開 昭和58年(1983)12月3日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

60目合わせ装置

願 昭57-91044

@出

60特

昭57(1982)5月28日

の発 明 者

岩松誠一

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

切出 願 人 株式会社諏訪精工会

東京都中央区銀座4丁目3番4

①代 理 人 弁理士 最上務

発明の名称

自会わせに問

特許額求の類的

半導体ウェーハ文持台鉄面には、少かくとも半 遊体への通貨を可能にする2つ以上の電荷が形成 されて田る年を好敬とする月合わせ数世。

3. 発明の詳細な説明

本発明は目合わせ銀光装置のウェーハ支持台報

従来、目合わ分解光描僧のウェーハ支持台は、 金属材料で構成され、温度調筋機能が付加されて いないのが適例であった。

従来の目合わせは光延期のウェーハ支持台に品 **府翻節預能を付加するには、ヒーターを支持台に** 挺め込む必要があるが、ヒーメーを支持台に期め 込むと、支持台の秘密特も大きくなり避難側折も

親居よく行えないという欠点があった。

本発明は上記従来技術の欠点をひらし、目合わ せ鮮光盛劇のウェーハ支持台を高積度に面皮部的 する 単が可能な ウェーハ 支持台機路を提供するこ とを目的とする。

上記目的を適屈するための本発明の指本的な機 成位、具合わせ乾燥化於て、半温体のェーハ支料 台製簡には、少なくとも必須なへの満定を可能に する2つ以上の護師が形成されて成る事を特別と

以下、少路例により本発明を評調に説明する。 旅 1 圏は本発明による目合せ装置の支持台の一 奥加朗を示す塾師の斯面構造である。

セクミックからなる支持台1には異常ケャック のための通気孔2が形成され、数面の中心部電板 (AM 又は Ag メッキ選ぎ)ろとそのリード放く、 および鉄面の偶形周辺背板をとそのリード殺らが 形成され、パウェーハフが支持台に真空チャック されると共に発揮る及び5Kその異面が接触し、 保护る。 5 削に適宜することがより必須休白仏の

特開設58-207634 (2)

4. 4. 9 ····· 1) - 1 A

8 …… 額度センサー

7 …… 半導体 ウェーハ

以 上

出願人 株式会社 脚肋相工会

代現人 作理士 岭上 转

本物放より目合わせが飲の支持台のよる半減体ウェーハの偏伸調節ドヤいては、支持台へは電停
形成のみで良く、熱容貴を小さくとることができ
高い物間の臨度調節が可能となり、かつ支持台への水管機構の組み込みも彩あとなる。この様だ半 調体ウェーハの高精度器度制御が可能となること け、ウェーハの結節器を制御して高材度の自合わせを可能とする効果がある。

4. 図面の簡単な説明

部 1 図は本発明による目合わせ装置の支持台級 造の一等施例の製部を示す断心的である。

1 …… 支持台茶板

2 …… 火 3 チャック孔

3 . 5 ····· 12 16

- 3 -

24 1 NV

-s - vie 4 1 vie 2